

割安感の強まった銘柄に注目

アジア半導体関連フォーカスファンド(愛称 ライジング・セミコン・アジア)
追加型投信/内外/株式

- ▶ 本レポートでは、当ファンドが投資している「Next Generation Semiconductor Asia Fund(円建て、ヘッジなしクラス)」(以下投資先ファンド)の運用経過と、運用チームによる今後の見通しについてご紹介いたします。



足元の投資環境について

米国株安などを受けてアジア株も調整

年初以降、アジア株は、米国景気がソフトランディング(軟着陸)するとの見方が強まったことや、生成AI向け半導体需要の増加期待などを背景に、堅調に推移しました。4月に一時調整する場面がありましたが、調整一巡後は、良好な決算を発表したテクノロジー株が主導する形で、米国株が反発し、アジア株も堅調に推移しました。しかし、その後、米バイデン政権による対中半導体規制の厳格化検討との報道があり、半導体関連株などテクノロジー株が大きく下落しました。8月に入ると経済指標で米国景気の減速も示されたことから、米国株を始めとしてアジア株も大幅な下落となりました。

また、米国における利下げと日銀による利上げが意識される展開となっており、外国為替市場では米ドル安・円高が進行しました(図表1)。こうした投資環境下、アジアの半導体関連株式も足元で調整色を強めており、株価変動も大きい展開となっています。当ファンドの基準価額も大幅な下落を余儀なくされたほか、円高進行の影響もあり、8月19日現在の当ファンドの基準価額は9,294円となりました。

当面は神経質な展開が続く

米国経済の減速懸念に加え、トランプ前大統領への銃撃事件、バイデン大統領の大統領選撤退表明など重要ニュースが相次ぎ、株式市場の変動性が高まっています。ただ、元々、米大統領選挙の前は株式市場の変動性が高まりやすい傾向があり、今回も11月の大統領選挙までは、神経質な展開が続く可能性があると考えられます。

図表1 アジア株式指数と米ドル/円の推移

(期間 2023年12月29日～2024年8月19日、日次)



※アジア株式指数: MSCI オール・カンントリー・アジア・インデックス (米ドル建て、配当込み)

図表2 基準価額の推移

(期間 2024年7月17日～2024年8月19日、日次)



(図表1の出所) Bloombergデータを基にSBI岡三アセットマネジメント作成

＜本資料に関してご留意いただきたい事項＞

■本資料は情報提供を目的としてSBI岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、ファンドの投資勧誘を目的として作成したものではありません。■本資料に掲載されている市況見通し等は、本資料作成時点での当社の見解であり、将来予告なしに変更される場合があります。また、将来の運用成果を保証するものではありません。■本資料は、当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■投資信託の取得の申込みに当たっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。



今後の運用方針

半導体株の調整は中期的な上昇の中の「小休止」

景気減速を受けて足元の企業決算に強弱感が入り混じっておりますが、中期的な見通しは変わらないと考えています。AIの開発競争は加速しており、一部のAIベンチャーが巨額の資金調達に成功したとの報道も出ています。

また、7月末に発表された米マイクロソフトの決算では設備投資の増加と先行きのAI投資の増額が示唆されました。こうしたAI関連投資は、半導体需要の増加に直結することから、引き続き半導体の需要環境が良好であることが確認できたと考えております。

運用チームでは、足元の半導体株の調整はあくまでも中期的な上昇の中の「小休止」であると考えており、魅力的な成長機会を提供していると考えています。当面は割安感の強まった銘柄に注目し、積極的な投資姿勢を維持する方針です。

AIやHBMに強い半導体関連銘柄に注目

投資先ファンドでは設定日以降、半導体関連銘柄の買い付けを進め、7月31日時点の株式組入比率は約95%となっております。

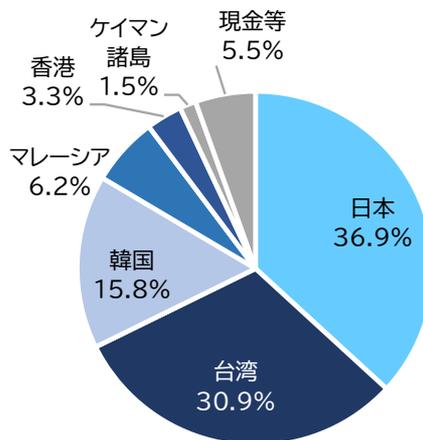
アジア地域においては、日本・台湾・韓国の大手半導体関連企業を中心に産業ピラミッドが形成されており、ポートフォリオにおいてもこれら3カ国への投資比率を高位としています(図表3)。これら3カ国には、半導体サプライチェーンにおいて「製造」「組立」を担う企業が豊富に存在することから、ニッチ領域で競争優位性を持つ銘柄を中心に中小型の組入比率を約64%としています。

当面、①AIチップ向け中心に微細化技術の中心的な役割を担う企業(TSMC、ASMP等)、②需要高まるHBM(High Bandwidth Memory、広帯域メモリ)メーカーや、HBM向けに製造装置・部材を供給する企業(SKハイニックス、アドバンテスト等)、③自動車向けに先端技術を提供する企業(eメモリー・テクノロジー、ルネサスエレクトロニクス等)、などに注目し、投資を行う方針です。

* 上記は、個別銘柄の推奨を目的として示したのではなく、当該銘柄の株価の上昇および投資先ファンドへの組入れを保証するものではありません。

図表3 国・地域別構成比率

(2024年7月31日時点)



※四捨五入しているため、合計が100%とならない場合があります。
※構成比率は投資先ファンドの純資産総額に対する比率です。

図表4 組入上位10銘柄

(2024年7月31日時点)

順位	銘柄名	国・地域名	比率	銘柄概要
1	台湾セミコンダクター (TSMC)	台湾	4.3%	スマートフォンやハイパフォーマンス・コンピューティング向け最先端半導体の製造を手掛ける。
2	アドバンテスト	日本	3.5%	半導体製品のウェハテスト、システムレベルテストなどを手掛ける。
3	メディアテック	台湾	3.5%	スマートフォンや様々なデバイス向け半導体の設計・開発を手掛ける。
4	ルネサスエレクトロニクス	日本	3.5%	自動車や産業向けのパワー・アナログ半導体を中心に幅広い半導体製品を手掛ける。
5	芝浦メカトロニクス	日本	3.4%	前工程から後工程まで特徴ある装置を提供しており、特に高精度のダイボンダー装置に強みを持つ。
6	eメモリー・テクノロジー	台湾	3.4%	不揮発性メモリー向けに幅広いIPを保有しており、半導体企業にライセンス供与を行う。
7	SKハイニックス	韓国	3.4%	DRAM、NANDフラッシュメモリ、SRAMチップなどを製造。
8	リノ・インダストリアル	韓国	3.4%	スマートフォンなどハイエンド半導体向けのテストソケットに強みを持つ。
9	イナリ・アマートン	マレーシア	3.4%	半導体の組み立てやテストなどのソリューションを提供する東南アジア大手。
10	ASMP	香港	3.3%	先端パッケージングやプリント基板の表面実装など幅広い製造装置を手掛ける。

※比率は小数点第2位を四捨五入して表示
※比率は投資先ファンドの純資産総額に対する比率です。

(図表3~4の出所)ニューバーガー・バーマンのデータを基にSBI岡三アセットマネジメント作成

<本資料に関してご留意いただきたい事項>

■本資料は情報提供を目的としてSBI岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、ファンドの投資勧誘を目的として作成したものではありません。■本資料に掲載されている市況見通し等は、本資料作成時点での当社の見解であり、将来予告なしに変更される場合があります。また、将来の運用成果を保証するものでもありません。■本資料は、当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■投資信託の取得の申込みには、投資信託説明書(交付目録見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。

アジア半導体関連フォーカスファンドに関する留意事項

【SBI岡三アセットマネジメントについて】

商号:SBI岡三アセットマネジメント株式会社

SBI岡三アセットマネジメント株式会社は、金融商品取引業者として投資運用業、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。登録番号は、関東財務局長(金商)第370号で、一般社団法人投資信託協会および一般社団法人日本投資顧問業協会に加入しています。

【投資リスク】

- 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。ファンドは、国内外の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
 - ファンドの主な基準価額の変動要因としては、各ファンド共通のリスクとして「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「特定の業種・テーマへの集中投資に係るリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、その他の変動要因としては「カントリーリスク」があります。
- ※ 基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。

【その他の留意点】

- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
 - 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
 - ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
 - 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。
 - 投資対象とする投資信託証券にかかる購入・換金申込の受付の中止および取消、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込の受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金申込の受付を取消することがあります。
- 詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」の「投資リスク」をご参照ください。

【お客様にご負担いただく費用】

<お客様が直接的に負担する費用>

- 購入時
購入時手数料 : 購入金額(購入価額×購入口数)×上限3.3%(税抜3.0%)
詳しくは販売会社にご確認ください。
- 換金時
換金手数料 : ありません。
信託財産留保額: 一口につき、換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3%

<お客様が信託財産で間接的に負担する費用>

- 保有期間中
運用管理費用(信託報酬): 純資産総額×年率1.2925%(税抜1.175%)
運用管理費用(信託報酬)の実質的な負担: 純資産総額×年率1.9425%程度
※実質的な負担とは、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた報酬です。なお、実質的な運用管理費用(信託報酬)は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
 - その他費用・手数料
監査費用: 純資産総額×年率0.0132%(税抜0.012%)
 - 有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を投資信託財産でご負担いただきます。また、投資対象とする投資信託証券に係る前記の費用等、海外における資産の保管等に要する費用等を間接的にご負担いただきます。(監査費用を除くその他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。)
- お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
- 詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」の「手続・手数料等」をご参照ください。

販売会社一覧

受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、販売会社には取次販売会社が含まれる場合があります。

商号	登録番号	加入協会			
		日本証券業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会
(金融商品取引業者)					
岡三証券株式会社	関東財務局長(金商)第53号	○	○	○	○
岡三にいがた証券株式会社	関東財務局長(金商)第169号	○			
FFG証券株式会社	福岡財務支局長(金商)第5号	○			○
三縁証券株式会社	東海財務局長(金商)第22号	○			
株式会社証券ジャパン	関東財務局長(金商)第170号	○	○		
三晃証券株式会社	関東財務局長(金商)第72号	○			
野畑証券株式会社	東海財務局長(金商)第18号	○			○

※岡三証券株式会社は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しております。

<本資料に関するお問い合わせ先>

フリーダイヤル 0120-048-214 (9:00~17:00 土・日・祝祭日・当社休業日を除く)